

# 苏州国芯科技股份有限公司

## 2024年9月3日至9月5日投资者关系活动记录表

证券简称：国芯科技

证券代码：688262

编号：2024-014

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	兴业基金；申万菱信基金；银河基金；长安基金；华富基金；朱雀基金；淳厚基金；民生证券；国信证券；国泰君安证券；中信建投证券；东方证券；江苏股投；老虎投资上海公司；上海智晶私募基金；檀真投资；磐厚动量资管；上海中道优创；上海日胜隆私募基金；苏州君子兰资本；福州万石投资。
时间	2024年9月3日；2024年9月4日；2024年9月5日。
地点	现场交流
上市公司参加人员姓名	证券事务代表：龚小刚先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>说明：对于已发布的重复问题和内容，本表不再重复记录，更多关于公司的情况敬请查阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的定期报告和临时报告。除重复问题及内容外，投资者本次提问的问题主要如下：</p> <p>1、公司致力于国产芯片设计和产业化应用的自主可控，公司与同行业其他芯片设计公司相比的主要优势有哪些，可以详细地介绍一下吗？</p> <p>答：与一般基于第三方IP集成的SoC芯片设计公司相比，公</p>

司具备嵌入式 CPU 和 NPU IP 核微架构按需定制化设计的能力，可以在满足 SoC 芯片的性能、效率、成本和功耗等资源状况下，根据应用系统的特点和需求，基于软硬件协同设计技术，进行更加合理的 SoC 芯片软硬件架构优化设计。经过二十多年的自主开发与创新，基于开源的 PowerPC、RISC-V 以及公司获得指令架构授权的 M\*Core 三种指令架构形成了具有自主知识产权的 C0、C200、C300、C400、C2000、C3000、C8000、C9000 和 CRV0、CRV4、CRV7 等 8 种 40 余款系列化 C\*Core CPU 核，性能指标可以满足客户应用需求，实现国产化替代。并且基于 C\*Core CPU 核推出了面向信创和信息安全应用领域、汽车电子和工业控制应用领域等 SoC 芯片设计平台，可以有效提高芯片设计效率和设计灵活程度，缩短设计周期，大幅提高芯片设计一次成功率。

## 2、请介绍一下公司汽车电子芯片研发的最新进展情况？

答：在汽车电子高端 MCU 方面，公司刚刚研发成功 CCFC3012PT，该款高端多核芯片主要用于新能源汽车域控制及辅助驾驶领域，对标目前被广泛使用的英飞凌高端 MCU 芯片 TC397，CCFC3012PT 芯片已给多家客户送样进行应用开发；而面向新能源汽车下一代跨域融合控制、智能辅助驾驶控制和动力底盘域控应用，公司正在进行 CCFC3009PT 高端 MCU 芯片的研发，该芯片有望可对标英飞凌于 2024 年推出的 TC4XX MCU 芯片。

除了继续拓展中高端 MCU 外，公司还在积极开发几款数模混合芯片，进一步扩充汽车电子“MCU+”的产品领域，包括：

（1）刚刚内部测试成功的集成化门区驱动控制芯片产品 CCL1100B，打破了 ST 在这个领域的垄断，目前正在送样阶段；

（2）底盘控制驱动芯片 CCL2200B 已完成设计，目前正在流片中，可实现对国外产品如 NXP 的 SC900719 系列相应产品的替代；

（3）BLDC 电机驱动芯片 CBC2100B 已完成首次流片，正在根据客户反馈进行设计优化，主要用于车载水泵/油泵及空调电机驱动控制，可实现对国外产品如 Infineon TLE988X、TLE989X 相应产

品的替代。

可以看出，公司的汽车电子芯片产品线正在变得更加全面，公司汽车电子芯片领域的铺天盖地发展战略正在不断落地，而“从客户中来、到客户中去”的产品布局具有扎实的现实需求基础，既能为公司带来相较竞争对手更为全面的优势，也可为公司客户提供具有更高性价比的套片方案，达到“双赢”。

### **3、公司的汽车电子芯片目前的应用进展情况怎么样？目前汽车电子领域的行业需求情况怎么样？**

答：在高强度的研发投入下，公司在汽车电子领域的产品加速推出，公司的12条产品线的产品型号越来越丰富，公司的多款芯片产品打破国外长期垄断，比如安全气囊点火驱动芯片CCL1600B、主动降噪DSP芯片CCD5001、刚刚内部测试成功的门区驱动芯片CCL1100B等，公司“顶天立地”的发展战略亦在不断地落实中，目前这些高端芯片产品或在开发应用中，或已经实现装机。

公司的汽车电子芯片越来越多地在主机厂和零部件厂商进行了定点开发，未来将有越来越多的项目进入量产状态。截至2024年6月30日，客户基于公司汽车电子芯片开发的项目数达到126个，同比增加125%；汽车电子芯片量产项目数26个，同比增加100%。与2023年12月31日相比，客户基于公司汽车电子芯片开发的项目数环比增加22.33%；汽车电子芯片量产项目数环比增加30%。

从公司上半年汽车电子芯片业务同比增长超四成的情况看，汽车电子产业链去库存进一步加快，预计下半年相关需求会得到进一步改善。

### **4、公司的下半年的业务展望如何？**

答：截至2024年6月30日公司的合同负债达到6.33亿元，同比增长79.41%，总体来说公司目前业务订单相对充沛，公司下半年业务有望获得可持续发展，这也是公司坚持长期主义的结

---

	果。
附件清单 (如有)	无
日期	2024年9月